

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2016-85913

(P2016-85913A)

(43) 公開日 平成28年5月19日(2016.5.19)

(51) Int.Cl.	F I	テーマコード (参考)
H05B 33/26 (2006.01)	H05B 33/26 Z	3K107
H01L 51/50 (2006.01)	H05B 33/14 A	
H05B 33/12 (2006.01)	H05B 33/12 B	
H05B 33/22 (2006.01)	H05B 33/22 Z	
H05B 33/06 (2006.01)	H05B 33/22 C	

審査請求 未請求 請求項の数 17 O L (全 19 頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号 特願2014-219280 (P2014-219280)
 (22) 出願日 平成26年10月28日 (2014.10.28)

(71) 出願人 502356528
 株式会社ジャパンディスプレイ
 東京都港区西新橋三丁目7番1号
 (74) 代理人 110000154
 特許業務法人はるか国際特許事務所
 (72) 発明者 佐藤 敏浩
 東京都港区西新橋三丁目7番1号 株式会
 社ジャパンディスプレイ内
 (72) 発明者 軍司 雅和
 東京都港区西新橋三丁目7番1号 株式会
 社ジャパンディスプレイ内
 Fターム(参考) 3K107 AA01 BB01 CC07 CC33 CC35
 DD03 DD22 DD27 DD37 DD38
 DD39 DD71 DD74 DD89 DD91
 DD92 DD93 FF00

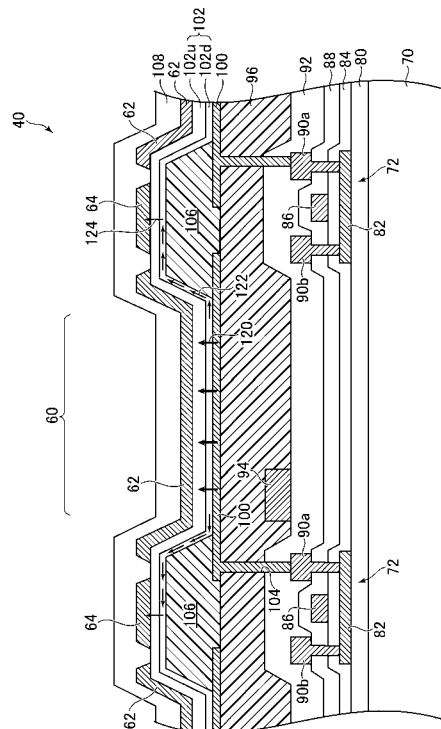
(54) 【発明の名称】 表示装置

(57) 【要約】

【課題】 自発光素子が配列された表示装置において、自発光素子に設けられた画像表示領域に亘る共通層を經由したリーク電流により隣接画素が意図せず発光する。

【解決手段】 有機EL表示装置2は、互いに隣接する第1の画素と第2の画素との境界に位置し、基材70に形成されたバンク106と、第1の画素と第2の画素とバンクとに跨って配置された発光素子層102を有する。第1の電極100は発光素子層102の基材70の側に、第1の画素と第2の画素との各々に独立して形成される。第2の電極62は発光素子層102の第1の電極100とは反対側に、第1の画素と第2の画素とに跨って形成される。第3の電極64は、平面的に見てバンク106と重畳する領域に、発光素子層102に接して形成される。

【選択図】 図5



【特許請求の範囲】**【請求項 1】**

第 1 の画素と前記第 1 の画素と隣接する第 2 の画素とを有する表示装置であって、
基材と、
前記第 1 の画素と前記第 2 の画素との境界に位置し、前記基材に形成されたバンクと、
前記第 1 の画素と前記第 2 の画素と前記バンクとに跨って配置された発光素子層と、
前記発光素子層の前記基材の側に、前記第 1 の画素と前記第 2 の画素との各々に独立して形成された第 1 の電極と、
前記発光素子層の前記第 1 の電極とは反対側に、前記第 1 の画素と前記第 2 の画素とに跨って形成された第 2 の電極と、
平面的に見て前記バンクと重畳する領域に、前記発光素子層に接して形成された第 3 の電極と、
を有することを特徴とする表示装置。

10

【請求項 2】

請求項 1 に記載の表示装置において、
前記第 2 の電極と前記第 3 の電極とは、異なる電位が印加され、
前記第 1 の電極と前記第 3 の電極との間の電位差は、前記第 1 の電極と前記第 2 の電極との間の電位差よりも大きいことを特徴とする表示装置。

【請求項 3】

請求項 1 又は請求項 2 に記載の表示装置において、
前記第 2 の電極は、前記バンクと重畳する前記領域にスリットを有し、
前記第 3 の電極は、前記スリットに、且つ前記第 2 の電極と同層に位置していることを特徴とする表示装置。

20

【請求項 4】

請求項 3 に記載の表示装置において、
前記第 1 の画素は、第 3 の画素と前記第 2 の画素とは異なる方向で隣接し、
前記第 3 の電極は、前記第 1 の画素と前記第 2 の画素との前記境界に沿って延在する延在部と、前記延在部から突き出た突起部とを有し、
前記突起部は、前記第 1 の画素と前記第 3 の画素との境界の少なくとも一部に位置していることを特徴とする表示装置。

30

【請求項 5】

請求項 1 又は請求項 2 に記載の表示装置において、
前記第 3 の電極は、前記発光素子層の前記基材とは反対側に位置し、且つ前記バンクと重畳する前記領域で絶縁膜に覆われ、
前記第 2 の電極は、前記バンクと重畳する前記領域で、前記絶縁膜を介して、前記第 3 の電極を覆っていることを特徴とする表示装置。

【請求項 6】

請求項 1 又は請求項 2 に記載の表示装置において、
前記第 3 の電極は、前記発光素子層と前記バンクとの間に位置していることを特徴とする表示装置。

40

【請求項 7】

請求項 6 に記載の表示装置において、
前記バンクの上面には凹部が形成され、
前記第 3 の電極は前記凹部を充填することを特徴とする表示装置。

【請求項 8】

請求項 6 に記載の表示装置において、
前記発光素子層は、少なくとも発光層と正孔輸送層とを有し、
前記第 3 の電極は、正孔輸送層と接していることを特徴とする表示装置。

【請求項 9】

請求項 6 に記載の表示装置において、

50

前記発光素子層は、少なくとも発光層と正孔注入層とを有し、
前記第3の電極は、正孔注入層と接していることを特徴とする表示装置。

【請求項10】

画像表示領域に画素となる発光領域が複数配列された表示装置であって、
前記画素の境界に沿って基材上に形成されたバンクと、
前記バンクが形成された前記基材上に、少なくとも前記発光領域に形成されキャリアを注入されて発光する発光層とキャリア移動性を有し前記画像表示領域に亘って形成された補助層とを含む複数層が積層されて形成された発光素子層と、
前記発光素子層の下に前記画素ごとに設けられた画素電極と、
前記発光素子層の上に配置され前記画素電極と共に前記発光素子層に電圧を印加する対向電極と、
前記画素間の境界領域にて前記発光素子層の上に配置され、前記発光素子層に電氣的に接続された境界電極と、
を有し、
前記境界電極は、前記発光素子層の前記境界領域における前記キャリアを引き寄せる電位を印加されて当該キャリアを吸収すること、
を特徴とする表示装置。

10

【請求項11】

画像表示領域に画素となる発光領域が複数配列された表示装置であって、
前記画素の境界に沿って基材上に形成されたバンクと、
前記バンクの上に置かれた境界電極と、
前記バンク及び前記境界電極が形成された前記基材上に、少なくとも前記発光領域に形成されキャリアを注入されて発光する発光層とキャリア移動性を有し前記画像表示領域に亘って形成された補助層とを含む複数層が積層されて形成された発光素子層と、
前記発光素子層の下に前記画素ごとに設けられた画素電極と、
前記発光素子層の上に配置され前記画素電極と共に前記発光素子層に電圧を印加する対向電極と、
を有し、
前記境界電極は、前記発光素子層に電氣的に接続され、前記発光素子層の前記境界領域における前記キャリアを引き寄せる電位を印加されて当該キャリアを吸収すること、
を特徴とする表示装置。

20

30

【請求項12】

請求項10に記載の表示装置において、
前記境界電極は、前記対向電極と同層で形成されること、を特徴とする表示装置。

【請求項13】

請求項10に記載の表示装置において、
前記対向電極は前記画像表示領域に亘り形成された透明導電材からなり、前記各画素に共通の基準電位を印加し、
前記画素電極は前記各画素の映像信号に応じた量のキャリアを前記発光素子層へ供給し、
前記境界電極は、前記対向電極の下に形成された不透明導電材からなること、
を特徴とする表示装置。

40

【請求項14】

請求項11に記載の表示装置において、
前記対向電極は前記各画素に共通の基準電位を印加し、
前記画素電極は前記各画素の映像信号に応じた量のキャリアを前記発光素子層へ供給し、
前記発光素子層は、前記画素電極から供給される前記キャリアについてのキャリア輸送層又はキャリア注入層を前記補助層として有し、当該補助層の上に前記発光層が積層されること、

50

を特徴とする表示装置。

【請求項 15】

請求項 11 に記載の表示装置において、
前記バンクはその上面に凹部を形成され、
前記境界電極は前記凹部を充填すること、
を特徴とする表示装置。

【請求項 16】

請求項 10 から請求項 15 のいずれか 1 つに記載の表示装置において、
前記対向電極は前記各画素に共通の基準電位を印加し、
前記画素電極は前記各画素の映像信号に応じた量の前記キャリアを前記発光素子層へ供給し、
前記境界電極は、前記画素電極との電位差が前記画素電極と前記基準電位との電位差より大きくなる電位を印加されること、
を特徴とする表示装置。

10

【請求項 17】

請求項 10 から請求項 15 のいずれか 1 つに記載の表示装置において、
前記画像表示領域は発光色の異なる複数種類の前記画素を含み、
前記境界電極は、前記発光色が異なる隣接した各画素対において当該画素間の境界の少なくとも一部に沿って配置されていること、
を特徴とする表示装置。

20

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は電圧印加により発光する自発光素子を用いた表示装置に関する。

【背景技術】

【0002】

表示装置として、有機エレクトロルミネッセンス (electroluminescence: EL) 素子などの自発光素子を用いたものの開発が進められている。有機エレクトロルミネッセンス素子は一般に OLED (organic light emitting diode) と称され、発光ダイオードの一種である。OLED は有機化合物からなる発光層にキャリア (電子や正孔) が注入され発光する。OLED は電圧の印加時に発光層に効率的にキャリアが注入されるように、電極と発光層との間などに、キャリア移動性を有した補助的な層を設ける構造が一般的となっている。

30

【0003】

例えば、補助的な層として、アノードと発光層 (emitting layer: EML) との間に、正孔輸送層 (hole transport layer: HTL) や正孔注入層 (hole injection layer: HIL) が設けられる。また、カソードと発光層との間には、電子輸送層 (electron transport layer: ETL) や電子注入層 (electron injection layer: EIL) が設けられる。これら補助層は例えば蒸着法などにより、複数の画素が配列された画像表示領域全体に亘って、即ち複数の画素に跨って連続して形成される。

40

【先行技術文献】

【特許文献】

【0004】

【特許文献 1】特開 2012 - 155953 号公報

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0005】

上述した OLED における HTL, HIL のようなキャリア移動性を有した層が画像表示領域に亘って連続する共通層として形成される発光素子を用いた表示装置は、当該共通層を通して隣接する画素間でのキャリアのリーク、即ち隣接画素へのリーク電流が発生し

50

得る。隣接画素へのリーク電流は当該隣接画素の意図しない発光を招くという問題があった。具体的には、リーク電流によって画像の解像度の劣化が生じる。また、発光色が異なる画素間におけるリーク電流では、色再現性（色純度）の低下が生じる。特に、高精細化による画素サイズの縮小に伴い隣接画素の開口部（又は発光領域）が接近すると、当該問題がより顕著となる。

【0006】

本発明は上記問題点を解決するためになされたものであり、隣接する画素の自発光素子へのリーク電流が抑制され、隣接画素の意図しない発光が防止される表示装置を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

10

【0007】

(1) 本発明に係る表示装置は、第1の画素と前記第1の画素と隣接する第2の画素とを有する表示装置であって、基材と、前記第1の画素と前記第2の画素との境界に位置し、前記基材に形成されたバンクと、前記第1の画素と前記第2の画素と前記バンクとに跨って配置された発光素子層と、前記発光素子層の前記基材の側に、前記第1の画素と前記第2の画素との各々に独立して形成された第1の電極と、前記発光素子層の前記第1の電極とは反対側に、前記第1の画素と前記第2の画素とに跨って形成された第2の電極と、平面的に見て前記バンクと重畳する領域に、前記発光素子層に接して形成された第3の電極と、を有する。

【0008】

20

(2) 他の本発明に係る表示装置は、画像表示領域に画素となる発光領域が複数配列された表示装置であって、前記画素の境界に沿って基板上に形成されたバンクと、前記バンクが形成された前記基板上に、少なくとも前記発光領域に形成されキャリアを注入されて発光する発光層とキャリア移動性を有し前記画像表示領域に亘って形成された補助層とを含む複数層が積層されて形成された発光素子層と、前記発光素子層の下に前記画素ごとに設けられた画素電極と、前記発光素子層の上に配置され前記画素電極と共に前記発光素子層に電圧を印加する対向電極と、前記画素間の境界領域にて前記発光素子層の上に配置され、前記発光素子層に電氣的に接続された境界電極と、を有し、前記境界電極は、前記発光素子層の前記境界領域における前記キャリアを引き寄せる電位を印加されて当該キャリアを吸収する。

30

【0009】

(3) さらに他の本発明に係る表示装置は、画像表示領域に画素となる発光領域が複数配列された表示装置であって、前記画素の境界に沿って基板上に形成されたバンクと、前記バンクの上に置かれた境界電極と、前記バンク及び前記境界電極が形成された前記基板上に、少なくとも前記発光領域に形成されキャリアを注入されて発光する発光層とキャリア移動性を有し前記画像表示領域に亘って形成された補助層とを含む複数層が積層されて形成された発光素子層と、前記発光素子層の下に前記画素ごとに設けられた画素電極と、前記発光素子層の上に配置され前記画素電極と共に前記発光素子層に電圧を印加する対向電極と、を有し、前記境界電極は、前記発光素子層に電氣的に接続され、前記発光素子層の前記境界領域における前記キャリアを引き寄せる電位を印加されて当該キャリアを吸収する。

40

【図面の簡単な説明】

【0010】

【図1】本発明の実施形態に係る有機EL表示装置の概略の構成を示す模式図である。

【図2】本発明の実施形態に係る有機EL表示装置の表示パネルの模式的な平面図である。

【図3】本発明の第1の実施形態に係る有機EL表示装置の表示領域の模式的な部分平面図である。

【図4】本発明の第1の実施形態に係る有機EL表示装置の表示領域における上部電極及び境界電極のレイアウトの一例を示す模式的な平面図である。

50

【図5】本発明の第1の実施形態に係る表示パネルの図3に示すV-V線に沿った位置での模式的な垂直断面図である。

【図6】本発明の第1の実施形態の変形例に係る有機EL表示装置の表示領域の模式的な部分平面図である。

【図7】本発明の第2の実施形態に係る有機EL表示装置の表示領域の模式的な部分平面図である。

【図8】本発明の第2の実施形態に係る表示パネルの図7に示すV I I I - V I I I線に沿った位置での模式的な垂直断面図である。

【図9】本発明の第3の実施形態に係る表示パネルの図7に示すV I I I - V I I I線に沿った位置での模式的な垂直断面図である。

【図10】本発明の第3の実施形態に係る表示パネルの製造工程の概略のフロー図である。

【図11】本発明の第3の実施形態の変形例に係る表示パネルの図7に示すV I I I - V I I I線に沿った位置での模式的な垂直断面図である。

【発明を実施するための形態】

【0011】

以下、本発明の実施の形態（以下実施形態という）について、図面に基づいて説明する。

【0012】

なお、開示はあくまで一例にすぎず、当業者において、発明の主旨を保つての適宜変更が容易に想到し得るものについては、当然に本発明の範囲に含有されるものである。また、図面は説明をより明確にするため、実際の態様に比べ、各部の幅、厚さ、形状等について模式的に表される場合があるが、あくまで一例であって、本発明の解釈を限定するものではない。また、本明細書と各図において、既出の図に関して前述したものと同様の要素には、同一の符号を付して、詳細な説明を適宜省略することがある。

【0013】

以下に説明する各実施形態の表示装置は有機EL表示装置である。有機EL表示装置は、アクティブマトリクス型表示装置であり、テレビ、パソコン、携帯端末、携帯電話等に搭載される。

【0014】

表示装置の画像表示領域には、画像を構成する複数の画素が2次元配列される。ここで、画像に対応する2次元の直交座標系の1つの座標軸に沿った方向を行方向、もう1つの座標軸に沿った方向を列方向とする。以降の説明では、行方向、列方向は基本的には画像の水平方向、垂直方向とするが、これは便宜的な定義である。例えば、同一の画像表示領域にて画像の縦横を切り換えて表示することができる表示装置では、画像表示領域の行方向、列方向はそれぞれ画像の垂直方向、水平方向となる場合がある。また、表示装置の構造自体も、以下に説明するものに対し行方向と列方向とを入れ替えたものとしてすることができる。

【0015】

また、以下の実施形態では、画像表示領域には発光色が互いに異なる複数種類の画素（サブピクセル）が配列されカラー画像を表示可能な表示装置を説明する。なお、カラー画像における画素は、表示装置における複数種類のサブピクセルからなる一組のサブピクセルに対応するが、表示装置ではサブピクセルが構成上の単位であり、例えば、サブピクセルごとにOLEDや画素回路が形成される。そこで以下の説明では、基本的にサブピクセルを画素と扱う。

【0016】

[第1の実施形態]

図1は実施形態に係る有機EL表示装置2の概略の構成を示す模式図である。有機EL表示装置2は、画像を表示する画素アレイ部4と、当該画素アレイ部を駆動する駆動部とを備える。有機EL表示装置2はガラス基板や可撓性を有した樹脂フィルムなどからなる

10

20

30

40

50

基材の上に薄膜トランジスタ (thin film transistor: TFT) や OLED などの積層構造が形成されている。

【0017】

画素アレイ部 4 には画素に対応して OLED 6 及び画素回路 8 がマトリクス状に配置される。画素回路 8 は複数の TFT 10, 12 やキャパシタ 14 で構成される。

【0018】

一方、駆動部は走査線駆動回路 20、映像線駆動回路 22、駆動電源回路 24、基準電源回路 26 及び制御装置 28 を含み、画素回路 8 を駆動し OLED 6 の発光を制御するなどの機能を担う。

【0019】

走査線駆動回路 20 は画素の水平方向の並び (画素行) ごとに設けられた走査信号線 30 に接続されている。走査線駆動回路 20 は制御装置 28 から入力されるタイミング信号に応じて走査信号線 30 を順番に選択し、選択した走査信号線 30 に、点灯 TFT 10 をオンする電圧を印加する。

【0020】

映像線駆動回路 22 は画素の垂直方向の並び (画素列) ごとに設けられた映像信号線 32 に接続されている。映像線駆動回路 22 は制御装置 28 から映像信号を入力され、走査線駆動回路 20 による走査信号線 30 の選択に合わせて、選択された画素行の映像信号に応じた電圧を各映像信号線 32 に出力する。当該電圧は、選択された画素行にて点灯 TFT 10 を介してキャパシタ 14 に書き込まれる。駆動 TFT 12 は書き込まれた電圧に応じた電流を OLED 6 に供給し、これにより、選択された走査信号線 30 に対応する画素の OLED 6 が発光する。

【0021】

駆動電源回路 24 は画素列ごとに設けられた駆動電源線 34 に接続され、駆動電源線 34 及び選択された画素行の駆動 TFT 12 を介して OLED 6 に電流を供給する。

【0022】

基準電源回路 26 は、OLED 6 のカソード電極を構成する共通電極 (図示せず) と、画素間の境界領域に配置され OLED 6 に電氣的に接続された境界電極 (図示せず) とに定電位を与える。

【0023】

本実施形態において OLED 6 の下部電極 (第 1 の電極) は画素ごとに形成された画素電極であり、OLED 6 の上部電極 (第 2 の電極) が画素電極に対向配置された対向電極となる。下部電極は駆動 TFT 12 に接続される。一方、上部電極は全画素の OLED 6 に共通の電極で構成される。本実施形態では下部電極が OLED 6 の陽極 (アノード) であり、上部電極が陰極 (カソード) である。

【0024】

図 2 は有機 EL 表示装置 2 の表示パネル 40 の模式的な平面図である。表示パネル 40 の表示領域 42 に図 1 に示した画素アレイ部 4 が設けられ、上述したように画素アレイ部 4 には OLED が配列される。矩形である表示パネル 40 の一辺には部品実装領域 46 が設けられ、表示領域 42 につながる配線が配置される。さらに部品実装領域 46 には駆動部を構成するドライバ IC 48 が搭載されたり、FPC 50 が接続されたりする。FPC 50 は制御装置 28 やその他の回路 20, 22, 24, 26 等に接続されたり、FPC 50 の主面上に IC を搭載されたりする。

【0025】

図 3 は表示領域 42 の模式的な部分平面図である。本実施形態の表示パネル 40 は、発光色が赤色 (R)、緑色 (G) 及び青色 (B) の 3 種類の画素 (サブピクセル) が行方向に周期的に配置され、列方向に同じ種類の画素 (サブピクセル) が並ぶストライプ配列である。表示領域 42 には RGB 画素それぞれに対応して発光領域となる画素開口 60r, 60g, 60b が配列され、それら画素開口同士の間は画素間の境界領域となり、該境界領域にはバンクが形成される。

10

20

30

40

50

【 0 0 2 6 】

上部電極 6 2 は各画素列に沿って延在し画素開口 6 0 を覆う。隣接する画素列の境界領域には境界電極 6 4 (第 3 の電極) が延在する。上述したように本実施形態では R G B 画素がストライプ配列され、行方向に隣り合う各画素対は互いに発光色が異なる。つまり、境界電極 6 4 は発光色が互いに異なる隣接画素間 (例えば隣接する第 1 の画素と第 2 の画素との間) の境界に沿って配置されている。

【 0 0 2 7 】

本実施形態の有機 E L 表示装置 2 はトップエミッション型であり、O L E D 6 で生じた光を上部電極 6 2 側へ出射させるため、上部電極 6 2 は透明導電材で形成される。境界電極 6 4 は例えば、上部電極 6 2 と同層の導電膜で形成することができる。具体的には、表示領域 4 2 に亘る透明導電膜を O L E D 6 上に成膜し、当該膜をパターンニングして上部電極 6 2 及び境界電極 6 4 を形成する。

10

【 0 0 2 8 】

図 4 は表示領域 4 2 における上部電極 6 2 及び境界電極 6 4 のレイアウトの一例を示す模式的な平面図である。上部電極 6 2 は図 3 に示した各画素列に垂直方向に延在される垂直部 6 2 v と、水平方向に延在し当該垂直部 6 2 v を互いに接続する水平接続部 6 2 h とを有するくし状の平面形状とすることができる。即ち、上部電極 6 2 は、各画素列境界に、換言すればバンクと平面的に見て重畳する領域に、スリットを設けた形状をしている。同様に、境界電極 6 4 は図 3 に示した各画素列境界に垂直方向に延在される垂直部 6 4 v と、水平方向に延在し当該垂直部 6 4 v を互いに接続する水平接続部 6 4 h とを有するくし状の平面形状とすることができる。上部電極 6 2 及び境界電極 6 4 はそれぞれ基準電源回路 2 6 に接続される。各画素の上部電極 6 2 は共通の電位 (基準電位 $R E F$) が印加される。また、境界電極 6 4 の各部は共通の電位 (電荷吸収電位 $A B$) が印加される。

20

【 0 0 2 9 】

図 5 は図 3 に示す V - V 線に沿った位置での表示パネル 4 0 の模式的な垂直断面図である。表示パネル 4 0 には T F T 7 2 などからなる回路や O L E D 6 などが形成される。この表示パネル 4 0 の構造はガラスや樹脂フィルムからなる基材 7 0 の上に各種の層を積み重ね、またパターンニングすることによって形成される。画素アレイ部 4 はトップエミッション型であるので、O L E D 6 で生じた光は基材 7 0 とは反対側、つまり図 5 において上向きに出射される。

30

【 0 0 3 0 】

具体的には基材 7 0 の上に、窒化シリコン ($S i N_y$) や酸化シリコン ($S i O_x$) などの無機絶縁材料からなる下地層 8 0 を介して、ポリシリコン ($p - S i$) 膜が形成され、当該 $p - S i$ 膜をパターンニングし、回路層で用いる箇所の $p - S i$ 膜を選択的に残す。例えば、 $p - S i$ 膜を用いてトップゲート型の T F T 7 2 のチャンネル部及びソース・ドレイン部となる半導体領域 8 2 が形成される。T F T 7 2 のチャンネル部の上にはゲート絶縁膜 8 4 を介してゲート電極 8 6 が配置される。ゲート電極 8 6 はスパッタリング等で形成した金属膜をパターンニングして形成される。この後、ゲート電極 8 6 を覆う層間絶縁膜 8 8 を積層する。T F T 7 2 のソース部、ドレイン部となる $p - S i$ にはイオン注入により不純物が導入され、さらにそれらに電氣的に接続されたソース電極 9 0 a 及びドレイン電極 9 0 b が形成される。このようにして T F T 7 2 を形成した後、層間絶縁膜 9 2 を積層する。層間絶縁膜 9 2 の表面には、スパッタリング等で形成した金属膜をパターンニングして配線 9 4 等を形成することができ、当該金属膜とゲート電極 8 6、ソース電極 9 0 a 及びドレイン電極 9 0 b の形成に用いた金属膜とで例えば、図 1 に示した走査信号線 3 0、映像信号線 3 2、駆動電源線 3 4 を多層配線構造で形成することができる。この上に例えば、アクリル樹脂等の有機材料を積層して平坦化膜 9 6 が形成され、これにより平坦化された表示領域 4 2 に O L E D 6 が形成される。

40

【 0 0 3 1 】

O L E D 6 は下部電極 1 0 0、発光素子層 1 0 2 及び上部電極 6 2 で構成され、これら下部電極 1 0 0、発光素子層 1 0 2 及び上部電極 6 2 は基材 7 0 の側からこの順に積層さ

50

れる。

【0032】

図5に示すTF T 7 2がnチャネルを有した駆動TF T 1 2であるとする、下部電極100はTF T 7 2のソース電極90aに接続される。具体的には、上述した平坦化膜96の形成後、下部電極100をTF T 7 2に接続するためのコンタクトホール104が形成され、平坦化膜96の表面及びコンタクトホール104内に形成した導電体膜をパターニングして、TF T 7 2に接続された下部電極100が画素ごとに分離して形成される。

【0033】

例えば、下部電極100はITO、IZOなどで形成される。また、本実施形態はトップエミッション型であるので、下部電極100は光反射率が高い材料で形成された反射層上に透明導電膜を積層した構造とすることができる。例えば、反射層はアルミニウム(A1)や銀(Ag)等で形成することができ、発光層からの光を表示面、つまり上部電極62側へ反射させる。

10

【0034】

上述したように、駆動TF T 1 2は各画素の映像信号に応じてOLED6に流れる電流を制御し、下部電極100は各画素の映像信号に応じた量のキャリアを発光素子層102へ供給する。具体的には本実施形態では下部電極100はアノードであり、キャリアとして正孔が下部電極100から発光素子層102へ供給される。

【0035】

下部電極100の形成後、バンク106を形成する。バンク106は例えば、アクリル、ポリイミド等の感光性樹脂をフォトリソグラフィ技術やインクジェット方式でパターニングして、隣接する画素の境界領域に形成される。なお、バンク106はSiN_yやSiO_xなどの無機絶縁材料で形成することもできる。バンク106で囲まれた領域が図3に示す画素開口60となり、当該領域には下部電極100が露出する。

20

【0036】

バンク106の形成後、発光素子層102を構成する各層が下部電極100の上に順番に積層される。発光素子層102はキャリアが注入されて発光する発光層(EML)、及び発光層への効率的にキャリアを供給する機能を担う補助層を含む。発光素子層102は補助層としてHIL及びHTLの少なくとも一方を含む。

【0037】

例えば、OLED6はRGB画素それぞれの発光色に対応した単色発光のOLEDであり、アノードである下部電極100側から順にHIL、HTL、EML、ETLが積層された構造である。当該構造ではHIL、HTL及びETLが補助層である。このうちHIL及びHTLは正孔を供給するアノード(下部電極100)と発光層(EML)との間に、表示領域42全体に亘って、即ち複数の画素に跨って連続して成膜される。またETLは電子を供給するカソード(上部電極62)と発光層(EML)との間に、表示領域42全体に亘って成膜される。尚、発光層(EML)は発光色ごとに異なる有機発光材料で形成される。

30

【0038】

また、OLED6は白色発光とすることもできる。この場合、OLED6の上方にカラーフィルタを配置して、画素に対応した色の光を出射させる。例えば、白色発光のOLED6は発光色が異なる複数の発光素子層102を光透過性の中間層を介して電氣的に直列接続したタンデム構造とすることができる。タンデム構造では中間層として設けられる電荷発生層(charge generation layer: CGL)もHIL、HTL等と同様、キャリア移動性を有する補助層である。

40

【0039】

図5では発光素子層102をHIL及びHTLからなる下層102dとEML及びETLからなる上層102uとに分けて示している。上層102uには、更にEILが含まれる場合も有る。

【0040】

50

例えば、HTL/HILは、ポリ(3,4-エチレンジオキシチオフエン)-ポリ(スチレンスルホン酸)(PEDOT- PSS)やその他の導電性有機材料で形成される。

【0041】

発光素子層102の上に上部電極62と共に境界電極64が形成される。図5に示すように、上部電極62はその端部をバンク106の端部にオーバーラップさせて画素開口60の上に形成され、境界電極64はバンク106の上に形成される。

【0042】

上部電極62及び境界電極64の表面に封止膜108が形成される。封止膜108は、水分などの透過を阻止し、OLED6を保護する機能を有する。封止膜108として例えば、SiN_y膜がCVD法によって成膜される。

10

【0043】

また、図5には示していないが、上部電極62の上を有機膜で覆うことで平坦化し、その後で全面を被覆するため封止膜108を形成してもよい。封止膜108は無機膜と有機膜の複数の積層構成を有してもよい。さらに、表示パネル40の表面の機械的な強度を確保するため、封止膜108の上には保護膜を形成してもよい。また、封止膜108の上には基材70のような基材(対向基材)を配置する(基材70に貼り付ける)こともできる。この場合、対向基材と封止膜108との間のスペースに充填材を充填してもよい。

【0044】

上述したように、有機EL表示装置2の駆動時においては、発光層(EML)に映像信号に応じたキャリアが供給されて、各画素のOLED6が発光する。図5には当該駆動時に下部電極100から発光素子層102へ供給されるキャリアである正孔の流れを矢印で模式的に示している。上部電極62には下部電極100より低い電位が印加され、各画素の下部電極100から発光素子層102の下層102dへ供給される正孔は基本的には当該下部電極100とこれに対向配置された上部電極62との間の電界に従い、矢印120で示すように発光素子層102の上層102uへ引き寄せられ当該画素の発光層(EML)に注入される。

20

【0045】

一方、下部電極100から下層102dに供給された正孔の一部は矢印122で示すように下層102d内を移動し、上述した隣接画素へ向かうリーク電流となる。有機EL表示装置2は、このリーク電流となる正孔を矢印124で示すように境界電極64で吸収する。これにより、隣接画素へのリーク電流の到達が阻止され、リーク電流による隣接画素の発光が防止される。よって、画像の解像度の低下が抑制される。また、境界電極64を互いに発光色が異なる隣接画素間の境界に配置することで、リーク電流による混色が抑制され高い色純度が得られ、好適な色再現性を実現できる。

30

【0046】

リーク電流となる正孔を境界電極64で吸収するために、境界電極64に印加する電荷吸収電位 V_{AB} は、発光素子層102内を隣接画素に向かって伝導するキャリアを、画素の境界領域にて引き寄せる電位に設定される。具体的には、本実施形態では正孔を吸収するために、電荷吸収電位 V_{AB} は下部電極100より低い電位に設定される。

【0047】

さらに、当該キャリアを効果的に吸収するには、境界電極64に印加する電荷吸収電位 V_{AB} と下部電極100の電位との差を、上部電極62に印加される基準電位 V_{REF} と下部電極100の電位との差より大きく設定することが好適である。すなわち、電荷吸収電位 V_{AB} を基準電位 V_{REF} より低い電位とすることでリーク電流となる正孔が境界電極64に吸収されやすくなる。例えば、基準電位 V_{REF} を0V、電荷吸収電位 V_{AB} を-2Vに設定することができる。

40

【0048】

なお、上部電極62と境界電極64との間隙部分における下層102dの電位は、上部電極62や境界電極64が配置された部分における下層102dの電位より高くなり、正孔の移動に対する電位障壁を形成し得る。つまり、リーク電流の進行方向に対して、隣接

50

画素の上部電極 6 2 が配置された部分より手前に当該上部電極 6 2 と境界電極 6 4 との間隙による電位障壁が形成され得る。このような効果を利用して、 $A B < R E F$ でなくても隣接画素へのリーク電流の到達を阻止できる構成とすることはできる。

【 0 0 4 9 】

O L E D 6 がタンデム構造である場合には、境界電極 6 4 は電荷発生層 (C G L) を経由して隣接画素へ移動する正孔も吸収し、C G L 経由のリーク電流も抑制する。

【 0 0 5 0 】

上述の説明では上部電極 6 2 と境界電極 6 4 とは同層の導電膜をパターンニングして形成したが、両電極を別工程で形成することもできる。この場合、境界電極 6 4 は上部電極 6 2 とは別の導電材料で形成することができ、例えば、I T O や I Z O などの透明導電材料より低抵抗な材料や不透明な材料を用いて境界電極 6 4 を形成することができる。例えば、境界電極 6 4 を不透明な金属で形成することで、隣接画素への光漏れを抑制して混色防止を図ることができる。

10

【 0 0 5 1 】

[第 1 の実施形態の変形例]

上記第 1 の実施形態では R G B 画素がストライプ配列された有機 E L 表示装置 2 における境界電極 6 4 によるリーク電流抑制構造を説明したが、当該リーク電流抑制構造は他の画素配列においても適用することができる。

【 0 0 5 2 】

図 6 は第 1 の実施形態の変形例に係る有機 E L 表示装置 2 a の表示領域 4 2 の模式的な部分平面図である。有機 E L 表示装置 2 a の表示領域 4 2 には発光色が異なる 4 種類の画素がマトリクス状に配列され、2 行 2 列の 4 画素が互いに異なる色で発光する。4 種類の画素は奇数行及び偶数行それぞれに 2 種類ずつ行方向に交互に配置されるか、または奇数列及び偶数列それぞれに 2 種類ずつ列方向に交互に配置される。具体的には、図 6 に示す例では、4 種類の発光色は R G B に加え、白色 (W) であり、例えば、奇数行に R 画素 1 3 0 r、W 画素 1 3 0 w が交互に配列され、偶数行に G 画素 1 3 0 g、B 画素 1 3 0 b が交互に配列される。なお、各行各列の 2 種類の発光色の組み合わせは図 6 に示したものに限定されない。

20

【 0 0 5 3 】

上記第 1 の実施形態のストライプ配列では列方向には同じ色の画素が並ぶので、列方向に隣接する画素間でのリーク電流は混色による画質劣化を生じない。そのため、画素行間の境界領域への境界電極 6 4 の配置は省略し、画素列間の境界領域にのみ境界電極 6 4 を配置する例を示した。

30

【 0 0 5 4 】

これに対し、図 6 に示す画素配列では行方向に隣接する画素間と列方向に隣接する画素間との両方にてリーク電流を抑制し、混色を防止することが好ましい。そこで、例えば、境界電極 6 4 は図 3 に示した、各画素列境界に垂直方向に延在される垂直部 6 4 v (延在部)、及び水平接続部 6 4 h に加え、各垂直部 6 4 v から各画素行境界に沿って突き出した水平突起部 6 4 p を備え、行方向と列方向との両方のリーク電流を抑制する。

40

【 0 0 5 5 】

ここで、上部電極 6 2 と境界電極 6 4 とを同層の導電膜で形成するので、画素行境界には列方向に隣接する画素間にて上部電極 6 2 をつなぐ接続部 6 2 j が必要になる。そのため、水平突起部 6 4 p (突起部) は列方向に隣接する画素の境界の全体に沿ってではなく一部のみに沿って形成される。

【 0 0 5 6 】

コンタクトホール 1 0 4 上に下部電極 1 0 0 を平坦に形成することが難しいことから、例えば図 5 においては、コンタクトホール 1 0 4 を画素開口 6 0 の領域内に形成するのではなく、バンク 1 0 6 が配置される領域内に形成している。しかし、画素の微細化に伴い、コンタクトホール 1 0 4 を画素の境界領域に納めることができなくなる場合がある。図 6 の画素レイアウトでは、画素開口 6 0 を矩形の一部を切り欠いた L 字形状とし、切り欠

50

いた領域にコンタクトホール104及びバンク106を形成している。このような画素レイアウトでは列方向に隣接する画素間における境界のうち、画素開口60間の距離が小さい個所と大きい個所とが生じる。そこで、画素開口60間の距離が小さい個所に水平突起部64pを設けリーク電流を好適に防止しつつ、画素開口60間の距離が大きい個所に接続部62jを設け上部電極62を列方向に接続することができる。

【0057】

[第2の実施形態]

以下、本発明の第2の実施形態に係る有機EL表示装置2bを説明する。本実施形態と上記第1の実施形態とは境界電極64及びそれに付随する構造に相違点を有し、その他の点では基本的に共通である。以下、第2の実施形態について第1の実施形態との相違点を中心に説明する。

10

【0058】

図7は有機EL表示装置2bの表示パネル40の表示領域42の模式的な部分平面図であり、図8は図7に示すV I I I - V I I I線に沿った位置での表示パネル40の模式的な垂直断面図である。有機EL表示装置2bは第1の実施形態と同様、RGB画素がストライプ配列された表示パネル40を備える。

【0059】

本実施形態では上部電極62と境界電極64とは別々の導電膜で形成され、これにより両電極の平面形状の自由度が高くなる。具体的には、境界電極64bをバンク106上に発光素子層102の上面に接して形成し、その後、上部電極62bを形成する。この構造では境界電極64bは各画素を取り囲む画素境界の全周に沿って配置することができる。すなわち、境界電極64bは格子状の平面形状とされ、画素列間の境界領域だけでなく画素行間の境界領域にも配置される。一方、上部電極62bは境界電極64bの上にも形成でき、基本的に表示領域42全体に亘って共通に形成される。なお、上部電極62bと境界電極64bとが重なる部分には両電極間に絶縁膜200が形成される。

20

【0060】

本実施形態によっても第1の実施形態と同様、HTL/HIL等のキャリア移動性を有した補助層を経由したリーク電流による隣接画素の発光を抑制することができる。また、本実施形態は、各画素の画素境界の全周に境界電極64を配置できるので、より好適に隣接画素へのリーク電流を抑制できる。

30

【0061】

境界電極64bは上部電極62bとは別の導電材料で形成することができ、第1の実施形態で述べたように、ITOやIZOなどの透明導電材料より低抵抗な材料や不透明な材料を用いて境界電極64bを形成することができる。例えば、境界電極64bを不透明な金属で形成することで、隣接画素への光漏れを抑制して混色防止を図ることができる。

【0062】

なお、本実施形態は第1の実施形態の変形例で述べたような、ストライプ配列以外の画素配列に容易に適用することができる。

【0063】

[第3の実施形態]

以下、本発明の第3の実施形態に係る有機EL表示装置2cを説明する。本実施形態と上記第1及び第2の実施形態とは境界電極64及びそれに付随する構造に相違点を有し、その他の点では基本的に共通である。以下、第3の実施形態について上記各実施形態との相違点を中心に説明する。

40

【0064】

有機EL表示装置2cの表示パネル40の表示領域42の模式的な部分平面図は、第2の実施形態について示した図7と基本的には同じであり、これを援用する。図9は図7に示すV I I I - V I I I線に沿った位置での有機EL表示装置2cの表示パネル40の模式的な垂直断面図である。

【0065】

50

本実施形態は第2の実施形態と同様、上部電極62と境界電極64とは別々の導電膜で形成され、これにより両電極の平面形状の自由度が高くなる。例えば、第2の実施形態と同様、境界電極64cは画素境界に沿った格子状の平面形状とし、上部電極62cは基本的に表示領域42全体に亘って共通に形成される。

【0066】

本実施形態が第2の実施形態と異なる点は、境界電極64cが発光素子層102の下に配置される点である。すなわち、バンク106の上面に境界電極64cが配置され、その後、発光素子層102、上部電極62が順次積層される。

【0067】

図9に示すように、境界電極64cはバンク106の上面及び側面に沿って積層されることが、換言すれば、境界電極64cはバンク106の側面とほぼ同じテーパー形状を有し且つバンク106の上面の上面全域に配置されることが、望ましい。これにより、境界電極64cの上層に配置される発光素子層102が、段切れなどの不具合が起こることなく、画素境界領域に好適に被覆されることになる。また、境界電極64cをパターニングする際のエッチングをウェットエッチングなどとし境界電極64cの端部の傾斜を緩やかにする等、画素境界領域の表面における角や段差を抑制する工夫をすることがさらに好適である。

10

【0068】

本実施形態によっても第2の実施形態と同様、HTL/HIL等のキャリア移動性を有した補助層を経由したリーク電流による隣接画素の発光を好適に阻止することができる。

20

【0069】

なお、補助層のうち下層102dに含まれるHILやHTLは、上層102uに含まれるETLやEILよりも比較的厚く形成されることが多い。よって、リーク電流となるキャリアの多くは、下層102d内を移動する。図9に示す本実施形態では、境界電極64が下層102dと接しているの、即ち、HIL或いはHTLの何れかと接しているの、当該キャリアを効率よく吸収し、下層102d内を経由するリーク電流を好適に抑制することができる。

【0070】

また、境界電極64cは上部電極62cとは別の導電材料で形成することができ、例えば、境界電極64cを低抵抗な金属で形成することができる。

30

【0071】

なお、本実施形態も第1の実施形態の変形例で述べたような、ストライプ配列以外の画素配列に容易に適用することができる。

【0072】

図10は、本実施形態に係る表示パネル40の製造工程の概略のフロー図である。表示パネル40の製造では、生産効率を高めるために、1枚の大きな基材70上に複数面の表示パネル40を同時に形成する手法が採用される。この製造手法では基材上へのTFTの形成などの工程は複数面の表示パネル40を一体に行われ、一方、OLED形成工程は複数面の表示パネル40を分割して行われる。つまり、この製造方法は、複数面の表示パネル40がつながった状態で加工される前段工程と、表示パネル40ごとに分割されて残りの加工が施される後段工程とに分けられ、ここでは前段工程をTFT工程、後段工程をOLED工程と呼ぶ。

40

【0073】

TFT工程は基本的に、集積回路などを製造する半導体製造プロセスを利用して行うことができる工程からなり、比較的プロセス条件の自由度が高く、例えば、数百程度の高温プロセスを利用するように製造工程を設計することも可能である。一方、OLED工程は、有機材料からなる発光素子層の劣化を防ぐため、雰囲気温度の上限が数十程度に制限され得る。つまり、OLED工程は、表示パネル40をそれぞれ加工することにより工数が増加し、またTFT工程に比べてより確実にプロセス条件を制御する必要がある。そのため、表示パネル40の製造工程においてTFT工程の占める割合を大きくし、OL

50

E D工程の占める割合を小さくすることで、表示パネル40の製造コストの低減や製造期間の短縮を図ることができる。

【0074】

本実施形態ではTFT工程として、基材70の上にTFT72などからなる回路を形成する工程(ステップS1)、その上に平坦化膜96を積層する工程(ステップS2)、下部電極100を形成する工程(ステップS3)、及びバンク106を形成する工程(ステップS4)が行われる。これらは第1の実施形態と同様に行うことができる。

【0075】

本実施形態では、さらに境界電極64cを形成する工程(ステップS5)がTFT工程として行われ、これにより、上に述べた製造コスト低減や製造期間短縮の効果が得られる。例えば、境界領域にバンク106が形成された後、表示領域42の全面に導電膜を形成し、フォトリソグラフィ技術を用いて当該導電膜をパターニングして、境界電極64cが形成される。

10

【0076】

なお、OLED工程は境界電極64cの形成後の工程、具体的には発光素子層102を形成する工程(ステップS6)、上部電極62cを形成する工程(ステップS7)、封止膜108を形成する工程(ステップS8)などを含む。

【0077】

本実施形態によっても上記各実施形態と同様、HTL/HIL等のキャリア移動性を有した補助層を経由したリーク電流による隣接画素の発光を阻止することができる。また、本実施形態は、各画素の画素境界の全周に境界電極64を配置できるので、より好適に隣接画素へのリーク電流を抑制できる。

20

【0078】

なお、本実施形態は第1の実施形態の変形例で述べたような、ストライプ配列以外の画素配列に容易に適用することができる。

【0079】

[第3の実施形態の変形例]

図11は第3の実施形態の変形例に係る有機EL表示装置2dの表示パネル40の模式的な部分断面図であり、第3の実施形態と同様、図7に示すV I I I - V I I I線に沿った位置での垂直断面図である。

30

【0080】

本変形例ではバンク106の上面に凹部300が形成され、当該凹部300に境界電極64dが充填される。例えば、境界電極64dはAgなどのナノ粒子を含んだナノインクで形成することができる。ナノインクは例えば、インクジェット法で凹部300に塗布・充填され、また、塗布後、減圧乾燥等により流動しにくくされる。その後、熱処理を施して、ナノインク層を溶融、焼成する。なお、凹部300を境界電極64dで埋めることで境界電極64d形成後の画素境界領域の表面はなだらかになり、その上に発光素子層102を画素境界領域に被覆することができる。

【0081】

凹部300は、バンク106を形成した後、エッチングで形成することができる。また、図11に示すようにバンク106が配置される個所の平坦化膜96の表面に凹部302を形成した後、バンク106を積層することでバンク106の上面の凹部300を形成することができる。例えば、平坦化膜96の凹部302は下部電極100をパターニングする際のエッチングで形成することができる。

40

【0082】

上記各実施形態及び変形例では、下部電極100がOLED6のアノード、上部電極62がOLED6のカソードである場合を説明した。しかし、本発明は、下部電極100がOLED6のカソード、上部電極62がOLED6のアノードである場合にも適用できる。その場合、発光素子層102における各層の積層順序は上述の構成とは逆転する。例えば、カソードである下部電極100側から順にEIL、ETL、EML、HTL、HIL

50

が積層された構造となる。また、当業者が理解し得るように、電流の向きや電位の大小関係が基本的に上記実施形態とは逆転する。

【0083】

本発明の実施形態として上述した有機EL表示装置2(2a, 2b, 2c, 2dを含む)を基にして、当業者が適宜設計変更して実施し得る全ての有機EL表示装置も、本発明の要旨を包含する限り、本発明の範囲に属する。また、有機EL表示装置以外の表示装置、例えば発光層として量子ドット素子を採用した量子ドット表示装置等も本発明の範囲に属する。

【0084】

本発明の思想の範疇において、当業者であれば、各種の変更例及び修正例に想到し得るものであり、それら変更例及び修正例についても本発明の範囲に属するものと了解される。例えば、前述の各実施形態に対して、当業者が適宜、構成要素の追加、削除若しくは設計変更を行ったもの、又は、工程の追加、省略若しくは条件変更を行ったものも、本発明の要旨を備えている限り、本発明の範囲に含まれる。

10

【0085】

また、本実施形態において述べた態様によりもたらされる他の作用効果について本明細書記載から明らかなもの、又は当業者において適宜想到し得るものについては、当然に本発明によりもたらされるものと解される。

【符号の説明】

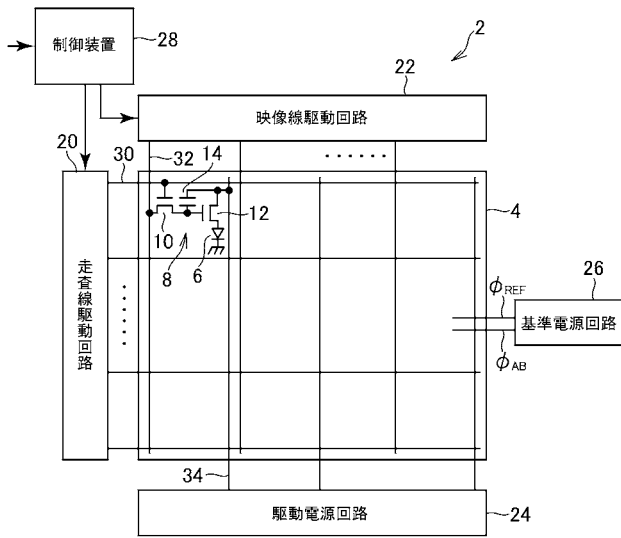
【0086】

2 有機EL表示装置、4 画素アレイ部、6 OLED、8 画素回路、10 点灯TFT、12 駆動TFT、14 キャパシタ、20 走査線駆動回路、22 映像線駆動回路、24 駆動電源回路、26 基準電源回路、28 制御装置、30 走査信号線、32 映像信号線、34 駆動電源線、40 表示パネル、42 表示領域、44 陰極、46 部品実装領域、48 ドライバIC、50 FPC、60 画素開口、62 上部電極、64 境界電極、70 基材、72 TFT、80 下地層、82 半導体領域、84 ゲート絶縁膜、86 ゲート電極、88, 92 層間絶縁膜、90a ソース電極、90b ドレイン電極、94 配線、96 平坦化膜、100 下部電極、102 発光素子層、104 コンタクトホール、106 バンク、108 封止膜、200 絶縁膜、300 凹部。

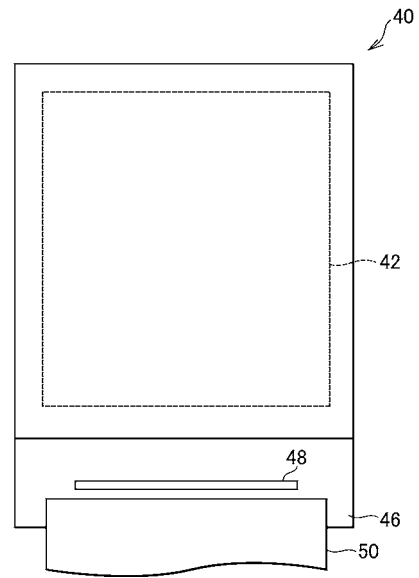
20

30

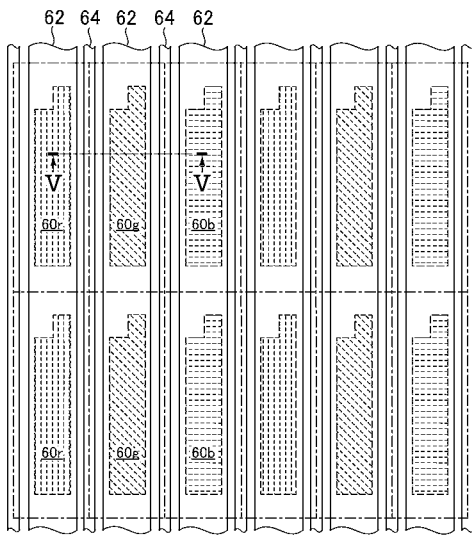
【 図 1 】



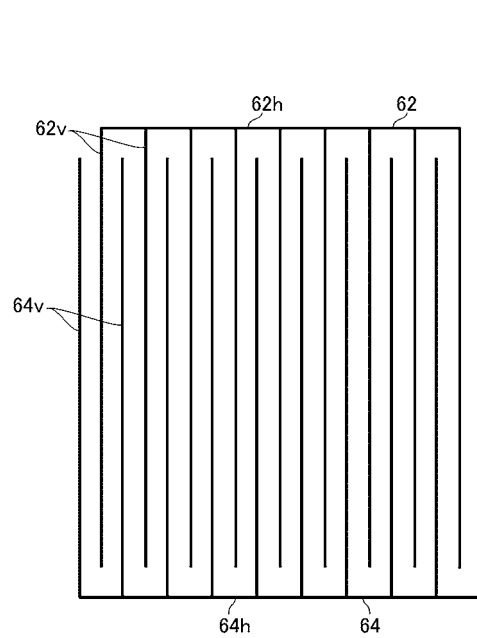
【 図 2 】



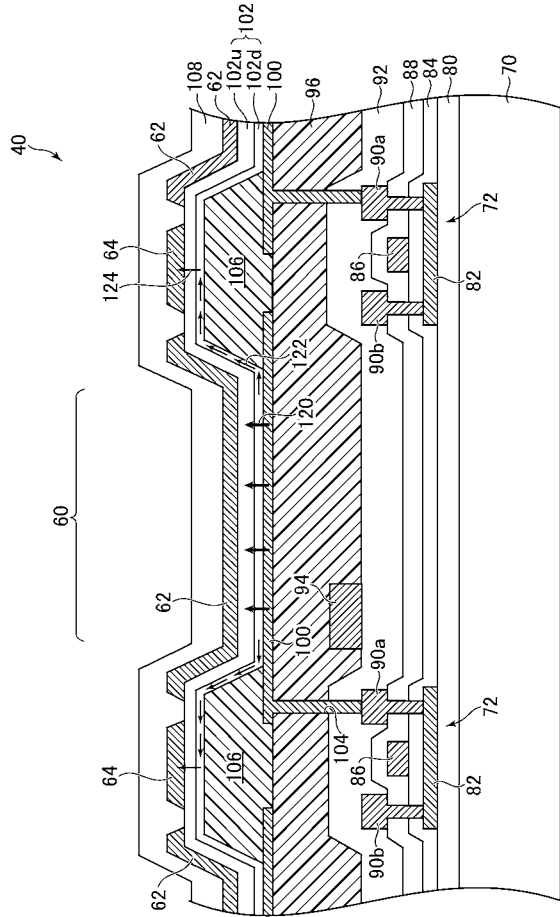
【 図 3 】



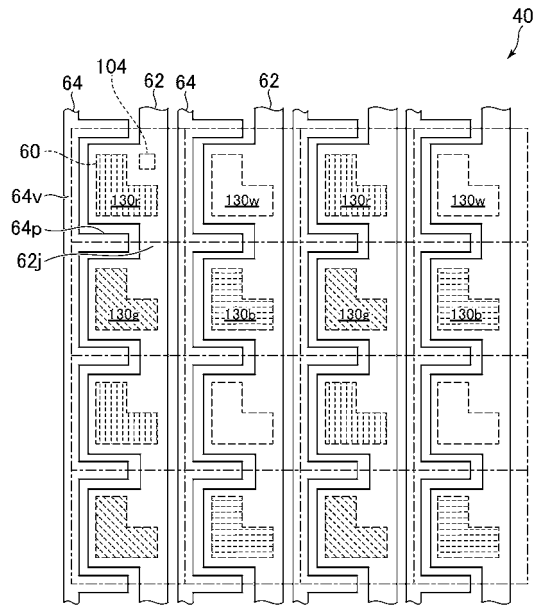
【 図 4 】



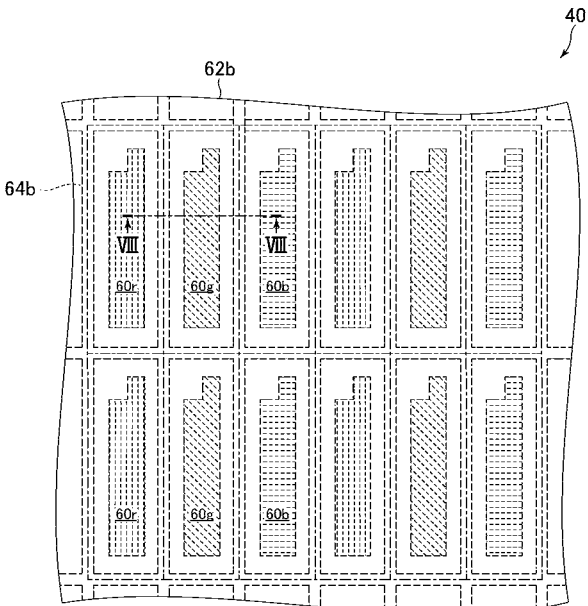
【図 5】



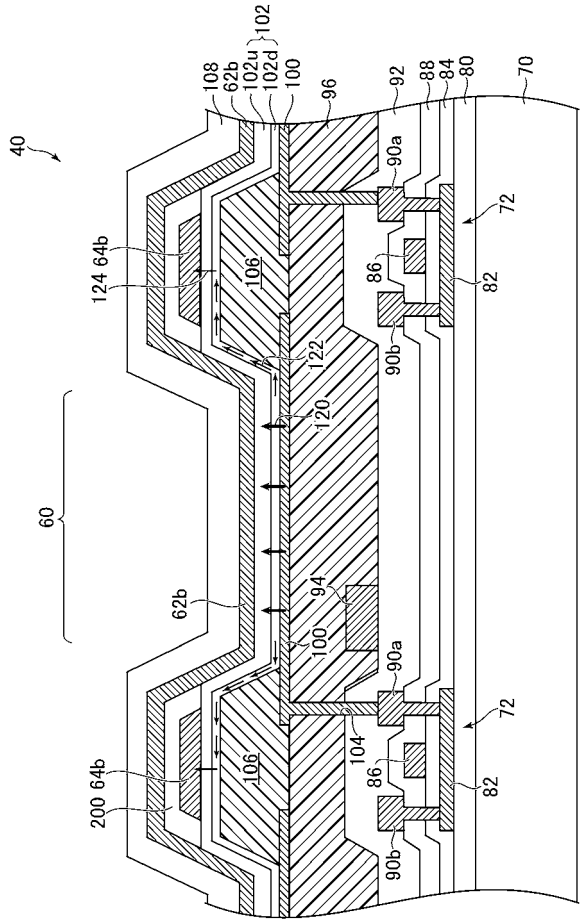
【図 6】



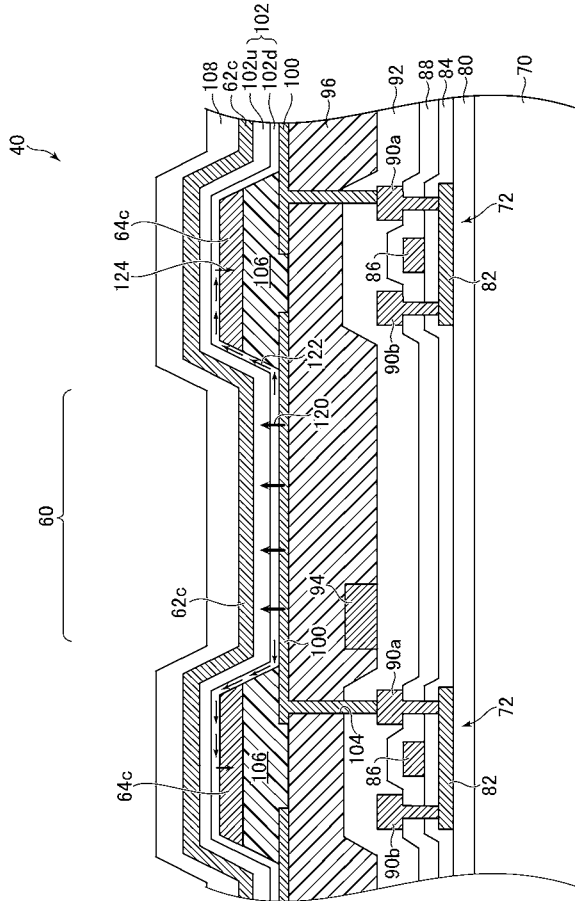
【図 7】



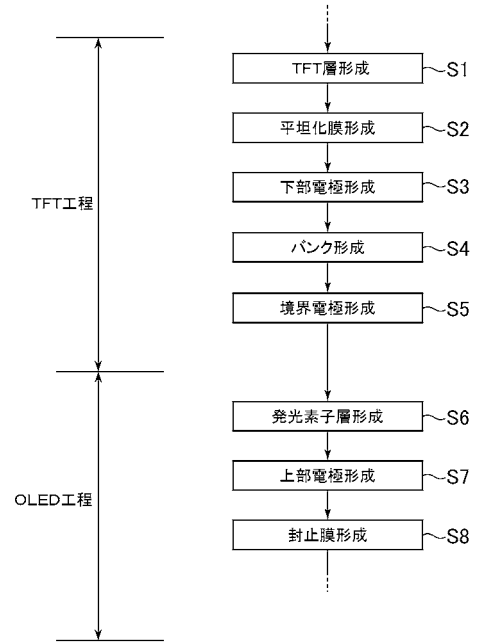
【図 8】



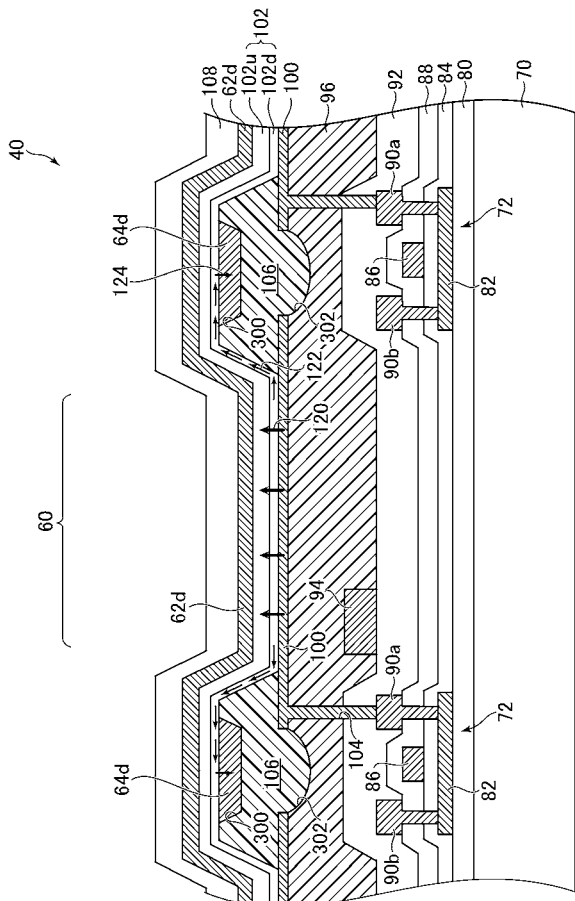
【図9】



【図10】



【図11】



フロントページの続き

(51)Int.Cl.		F I		テーマコード(参考)
H 0 5 B 33/28	(2006.01)	H 0 5 B	33/22	A
		H 0 5 B	33/06	
		H 0 5 B	33/28	

专利名称(译)	表示装置		
公开(公告)号	JP2016085913A	公开(公告)日	2016-05-19
申请号	JP2014219280	申请日	2014-10-28
[标]申请(专利权)人(译)	株式会社日本显示器		
申请(专利权)人(译)	有限公司日本显示器		
[标]发明人	佐藤敏浩 軍司雅和		
发明人	佐藤 敏浩 軍司 雅和		
IPC分类号	H05B33/26 H01L51/50 H05B33/12 H05B33/22 H05B33/06 H05B33/28		
CPC分类号	H01L27/3246 H01L27/3211 H01L27/3276 H01L51/5203 H01L51/5225		
FI分类号	H05B33/26.Z H05B33/14.A H05B33/12.B H05B33/22.Z H05B33/22.C H05B33/22.A H05B33/06 H05B33/28 G09F9/30.365 H01L27/32		
F-TERM分类号	3K107/AA01 3K107/BB01 3K107/CC07 3K107/CC33 3K107/CC35 3K107/DD03 3K107/DD22 3K107/DD27 3K107/DD37 3K107/DD38 3K107/DD39 3K107/DD71 3K107/DD74 3K107/DD89 3K107/DD91 3K107/DD92 3K107/DD93 3K107/FF00		
其他公开文献	JP6546387B2 JP2016085913A5		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

在其中布置有自发光元件的显示装置中，由于漏电流通过设置在自发光元件中的图像显示区域上的公共层而相邻的像素无意地发光。解决方案：有机EL显示装置2包括形成在第一像素和第二像素之间的边界处的堤106，第一像素和第二像素彼此相邻并形成在基材70，第一像素和第二像素上并且发光元件层102布置成在堤岸上延伸。第一电极100独立地形成在发光元件层102的基材70侧的第一像素和第二像素中的每一个上。第二电极62形成在与发光元件层102的第一电极100相对的一侧上，以跨越第一像素和第二像素。当在平面图中观察时，第三电极64形成在与堤106重叠的区域中与发光元件层102接触。点域5

